

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2023-024

上海芯导电子科技股份有限公司

2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股权登记日：2023 年 6 月 7 日
- 除权日：2023 年 6 月 8 日
- 本次上市无限售股份数量：8,210,800 股
- 上市日期：2023 年 6 月 8 日
- 是否涉及差异化分红送转：否

一、 新增无限售流通股上市情况

（一） 权益分派方案简述：

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 84,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 50,400,000 元，转增 33,600,000 股，本次分配后总股本为 117,600,000 股。

（二） 股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为：2023 年 6 月 7 日。

本次权益分派的除权日为：2023年6月8日。

(三) 上市数量

本次上市无限售股份数量为：8,210,800股

(四) 上市时间

本次上市流通日期为：2023年6月8日

二、 有关咨询办法

联系部门：证券部

联系电话：021-60753051

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2023年6月8日